

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 技術支援部



湯浅 剛

【お詫び】TE7774APF 成分表の相違について

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたくお礼申し上げます。

さて表題の件につき、この度、当初に提出させて頂いた、当該 IC の成分表に間違いがある旨 IC 製造メーカーより連絡がございました。謹んでお詫び申し上げますと共に、現在は書類を提出する専門部署を設け、完全システム化をし再発防止に努めてまいりますので、何卒ご容赦の程重ねてお願い申し上げます。ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

敬具

記

1. 該当 IC : TE7774APF

2. 内容:

①この度、TE7774APFの生産工場の移転に伴い、ハロゲンフリー化をする旨貴社にご連絡致しましたが、実際は弊社に最初に納入されたものから既にハロゲンフリー化されており、その際にIC製造メーカーより入手した成分表が間違っていた事が判明しました。

成分表正誤表

部位	誤り	正しい（現行品：ハロゲンフリー品）
封止樹脂	Sb203（三酸化アンチモン）	—（未使用）
	有機リン化合物	—（未使用）
	臭素系難燃剤	—（未使用）
	フェノール化合物	フェノール化合物
	SiO2（シリカ）	SiO2（シリカ）
	カーボンブラック	カーボンブラック
	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂

②今回、工場移管（※）に伴い、ハロゲンフリー封止樹脂の成分変更を行います。

工場移管による変更表

部位	現行品（ハロゲンフリー品） 添付：K-1-7774APF	工場移管後（ハロゲンフリー品） 添付：K-2-7774APF
封止樹脂	—（未使用）	有機リン化合物
	フェノール化合物	—（未使用）
	SiO2（シリカ）	SiO2（シリカ）
	カーボンブラック	カーボンブラック
	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂

※）富士通インテグレートドマイクロテクノロジー株式会社 岐阜工場

↓

富士通インテグレートドマイクロテクノロジー株式会社 九州工場へ変更

写し）インレビウム営業部 部長 千野

インレビウム営業部 グループリーダー 武藤

以上

資料番号 : K-1-TE7774APF
作成日 : 平成 20 年 9 月 11 日
東京エレクトロニクス株式会社
インレビウム事業部

製品に含まれる化学物質情報

1. 対象製品 : TE7774APF
2. 製品質量 : 1.7g
3. 上記製品 1 個当りに含有する化学物質は、下表の内容です。

No.	部位	CAS-NO	物質名	含有量(mg)	含有率(%)
1	ダイ付け剤	7440-22-4	銀	4.76775	0.280553306
2	リード外装メッキ	7440-69-9	ビスマス	0.41	0.024126025
3	リード外装メッキ	7440-31-5	錫	20	1.176879267
4	封止樹脂		フェノール化合物	12.8064924	0.75358477
5	封止樹脂	7631-86-9	シリカ	960.48693	56.51885773
6	封止樹脂	1333-86-4	カーボンブラック	1.28064924	0.075358477
7	封止樹脂		エポキシ樹脂	306.0751684	18.010676
8	リードフレーム	7440-02-0	ニッケル	144.5708477	8.507121665
9	リードフレーム	7439-89-6	鉄	199.6454563	11.74792992
10	リードフレーム	7440-22-4	銀	8	0.470751707
11	ワイヤー	7440-57-5	金	2.856	0.168058359
12	チップ	7440-21-3	シリコン	38.51036967	2.266102782

※砒素はチップ中にイオン化し打ち込み、素子材料として含有していますが、微量の為表からは除外しています。チップ全面に打ち込む（現実には有り得ませんが、理論上の最大値）と仮定して、チップ重量に対し 11ppm の含有となります。

資料番号：K-2-7774APF

作成日：平成 20 年 9 月 11 日

東京エレクトロデバイス株式会社

インレビウム事業部

製品に含まれる化学物質情報

1. 対象製品： TE7774APF
2. 製品質量： 1.7g
3. 上記製品 1 個当りに含有する化学物質は、下表の内容です。

No.	部位	CAS-NO	物質名	含有量(mg)	含有率(%)
1	ダイ付け剤	7440-22-4	銀	4.77	0.280588235
2	リード外装メッキ	7440-69-9	ビスマス	0.41	0.024117647
3	リード外装メッキ	7440-31-5	錫	20	1.176470588
4	封止樹脂		有機リン化合物	51.23	3.013529412
5	封止樹脂	7631-86-9	シリカ	1163.41	68.43588235
6	封止樹脂	1333-86-4	カーボンブラック	2.56	0.150588235
7	封止樹脂		エポキシ樹脂	64.03	3.766470588
8	リードフレーム	7440-02-0	ニッケル	144.57	8.504117647
9	リードフレーム	7439-89-6	鉄	199.65	11.74411765
10	リードフレーム	7440-22-4	銀	8	0.470588235
11	ワイヤー	7440-57-5	金	2.86	0.168235294
12	チップ	7440-21-3	シリコン	38.51	2.265294118

※砒素はチップ中にイオン化し打ち込み、素子材料として含有していますが、微量の為表からは除外しています。チップ全面に打ち込む（現実には有り得ませんが、理論上の最大値）と仮定して、チップ重量に対し 11ppm の含有となります。